【19】中華民國　　【12】專利公報　（U）

【11】證書號數：M687996
【45】公告日： 中華民國 115 (2026) 年 10 月 01 日
【51】Int. Cl.：　*F28D15/00 (2006.01)*　*H05K7/20 (2006.01)*
F28F3/02 (2006.01)　*F28F13/06 (2006.01)*
新型　　全 7 頁

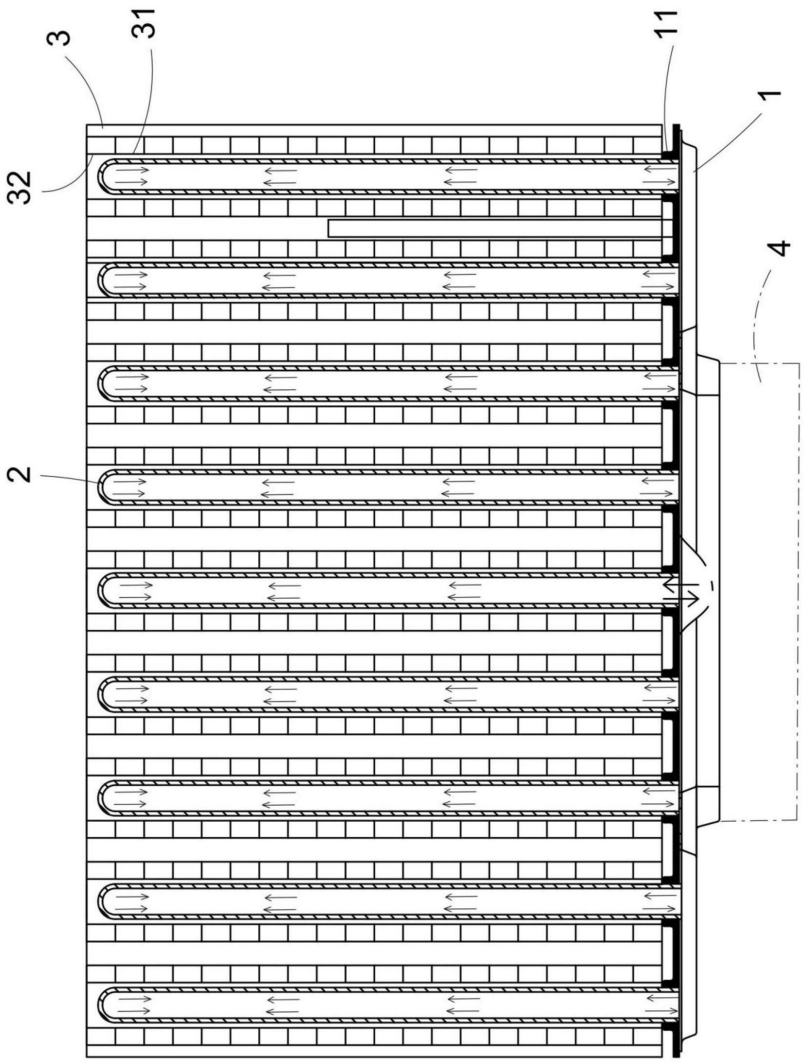
【54】名　　稱：　提升散熱效率之散熱結構
【21】申請案號：　114213438　　【22】申請日： 中華民國 114 (2025) 年 12 月 18 日
【72】新型創作人：曾慶瑜 (TW)
【71】申 請 人：　曾慶瑜
臺北市萬華區民和街 19 號 11 樓
【74】代 理 人：　陳吉隆

【57】申請專利範圍

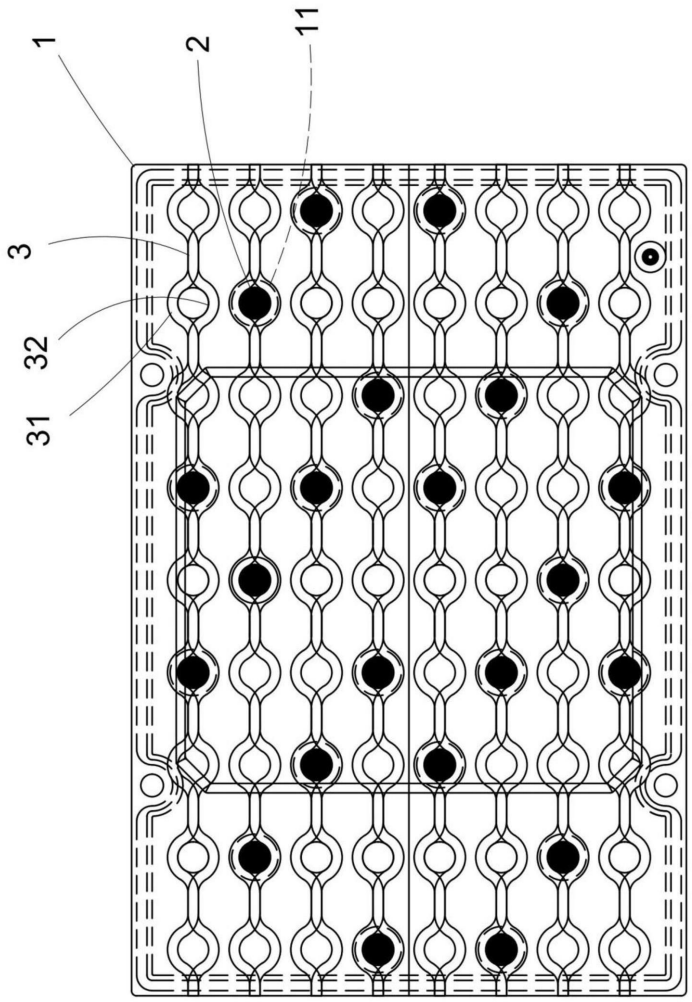
1. 一種提升散熱效率之散熱結構，其包括均溫板、導熱管及散熱片元件，其主要特徵為：於所述均溫板上蓋分佈設有至少一個以上供組設導熱管之組接通孔，可使組裝後之每一導熱管內之工作液與均溫板內之工作液形成一體貫通的流動循環狀態，於所述導熱管上組裝有至少一散熱片元件，均溫板接受電子元件熱源後將電子元件之熱源帶走向上分別直接進入每一導熱管內，導熱管再將熱源傳導至組合於導熱管上之散熱片元件，再由風流將熱源帶走而降溫，而可縮短及快速將電子元件熱源帶走降溫之時間，大幅提升電子元件散熱之效果。
2. 如請求項 1 所述提升散熱效率之散熱結構，其中散熱片元件係具有多數列一上、一下之連續圓弧凸部，且每一列一上、一下之連續圓弧凸部，以增加與空氣接觸的機率，提升散熱效果。
3. 如請求項 2 所述提升散熱效率之散熱結構，其中散熱片元件所具有多數列一上、一下之連續圓弧凸部亦構成有供導熱管穿過之孔洞，並於每一導熱管穿過散熱片元件之每一孔洞處均施以焊接加工，以使導熱管可與散熱片元件間產生密合接觸狀態，而提升熱傳導效果。
4. 如請求項 1 所述提升散熱效率之散熱結構，其中於散熱片元件每一圓弧凸部可加工分佈有多數花紋，使散熱分散且增加與空氣接觸率，並產生高低落差，使風流吹過時產生亂流而將熱源帶走，大幅提升電子元件散熱之效果。
5. 如請求項 1 所述提升散熱效率之散熱結構，其中散熱片元件係以熱傳導及散熱性佳之金屬材料製成。

圖式簡單說明

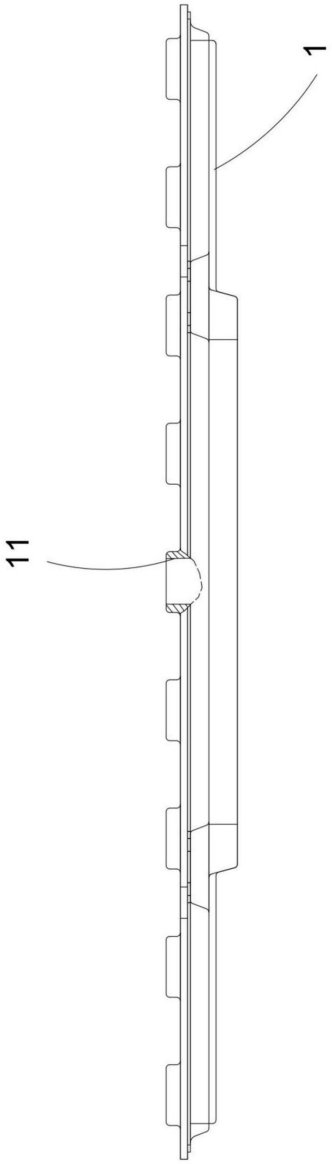
第一圖係本創作試舉其中一種較佳實施例之局部剖示圖。
第二圖係第一圖所示結構之俯視圖。
第三圖係本創作均溫板之側面局部剖示圖。
第四圖係本創作均溫板之俯視圖。
第五圖係本創作試舉其中一種散熱片元件實施例之局部立體圖。
第六圖係本創作於散熱片元件每一圓弧凸部可加工分佈有多數花紋之局部立體圖。



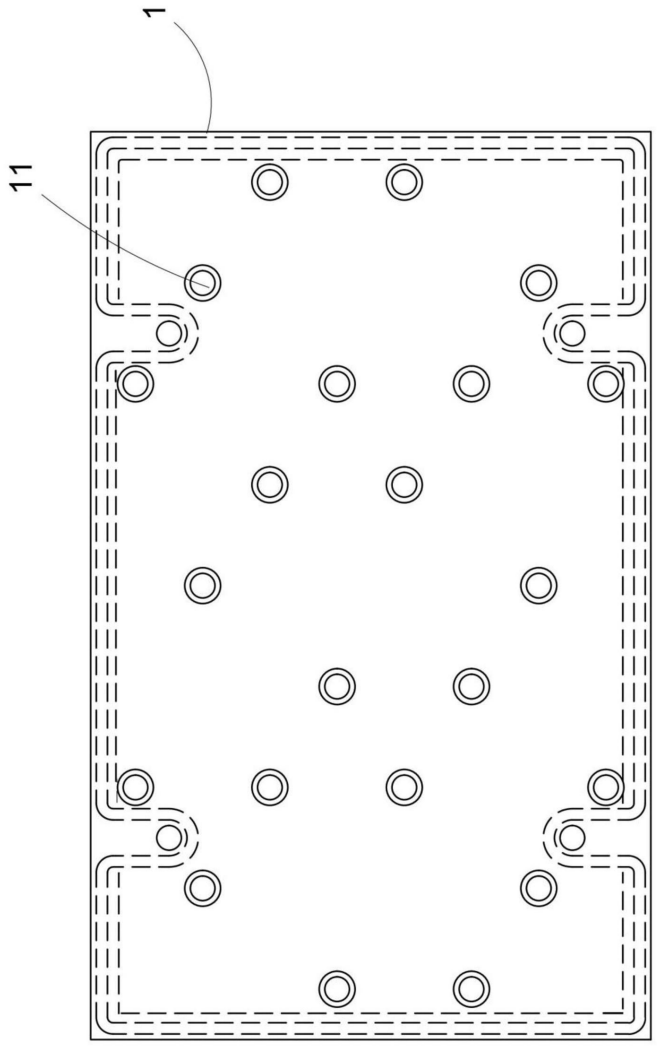
【第一圖】



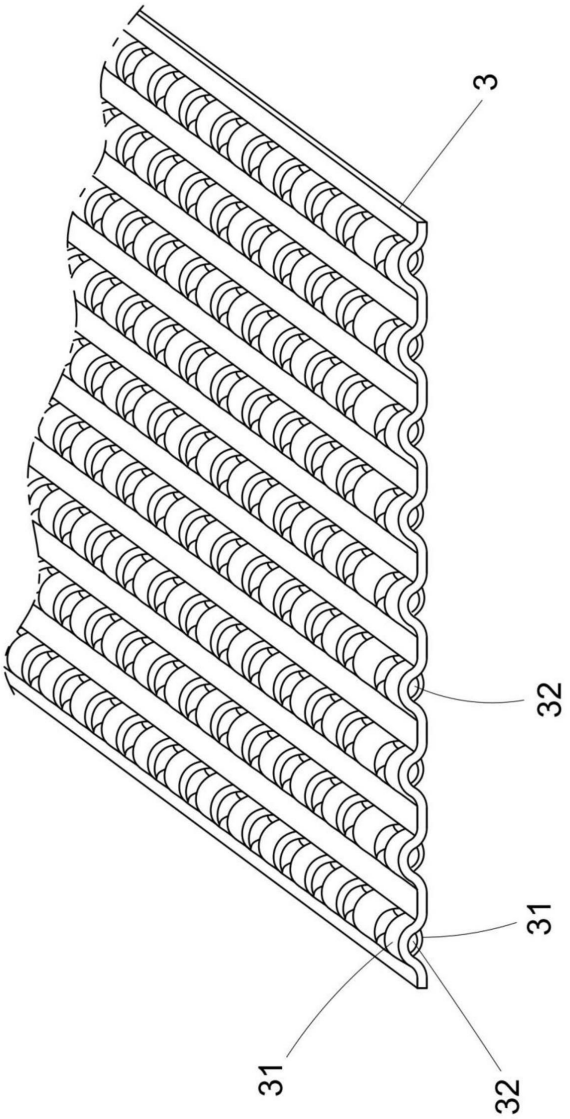
【第二圖】



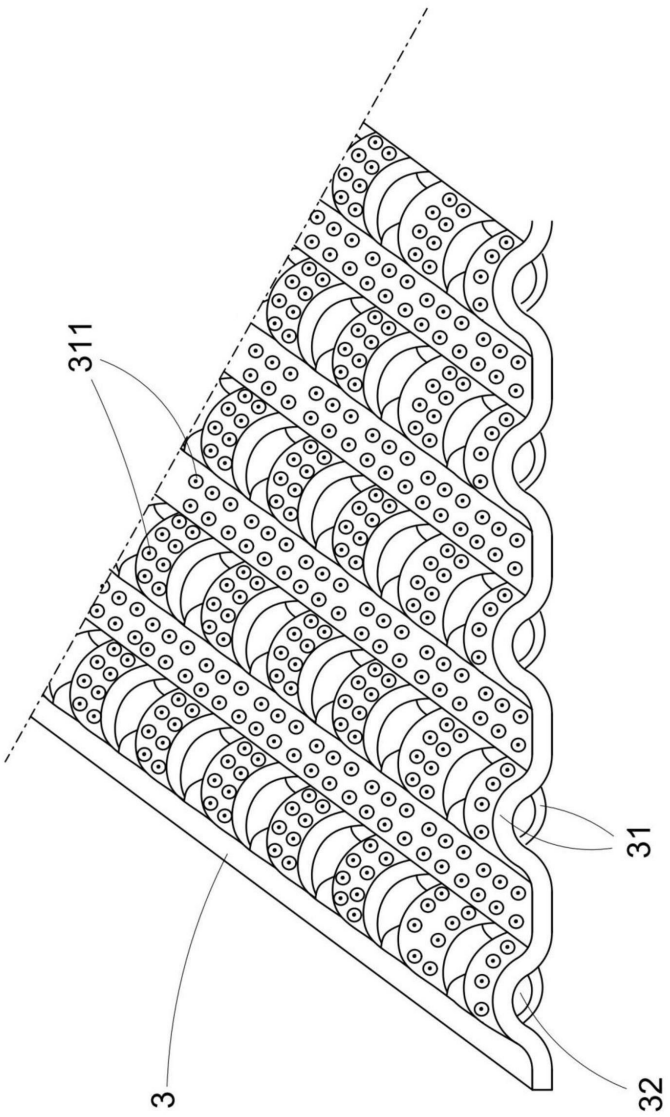
【第三圖】



【第四圖】



【第五圖】



【第六圖】